

# 2018年3月期決算説明会資料

2018年6月13日



## I. 当社の概要、当社の特徴

---

## II. 2018年3月期 決算概況

---

## III. 2019年3月期 業績予想

---

## IV. 中期経営計画と進捗状況

---

# I

## 当社の概要、当社の特徴

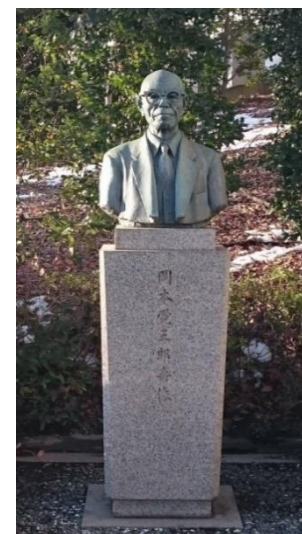
# ○ 世界唯一の総合砥粒加工機メーカー

## ≫ 会社概要

会社名 英文	株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
創業	大正15年11月
設立	昭和10年6月
資本金	48億8051万円
本社所在地	〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
事業内容	【各種研削盤・半導体関連装置の製造・販売】 研削盤（平面・成形・円筒・内面・歯車・周辺機器） 半導体関連装置（グラインディング・ポリッシング・ラッピング・スライシング）
従業員数	連結: 約1,950名 単体: 387名 ※2018年3月末現在



大正15年 (1926年)	岡本覚三郎が岡本専用工作機械製作所を創業
昭和5年 (1930年)	国産初の歯車研削盤 ASG-2型を完成
昭和10年 (1935年)	(株) 岡本工作機械製作所創立
昭和28年 (1953年)	国産初の平面研削盤PSG-6型完成
	
昭和30年 (1955年)	国産初の外周刃スライシングマシン PSG-3GE型を完成
昭和38年 (1963年)	東京証券取引所市場第二部上場
昭和43年 (1968年)	世界初のCNC成形研削盤 NFG-5型を完成
昭和47年 (1972年)	米国に、オカモト・コーポレーション設立
昭和48年 (1973年)	シンガポール工場完成
昭和57年 (1982年)	群馬県安中市に安中工場完成
昭和61年 (1986年)	タイ工場完成
平成4年 (1992年)	ドイツに、オカモト・ヨーロッパ設立
平成8年 (1996年)	半導体事業本部を設立
平成9年 (1997年)	全自動立型高精度平面研削盤の開発で日本機械学会 技術賞受賞 全自動高精度高能率CMP装置の開発で砥粒加工学会 技術賞受賞
平成12年 (2000年)	高精度成形研削盤 UPZシリーズを完成
平成13年 (2001年)	スキヤニングポリシャーGNX300Pを完成
平成14年 (2002年)	中国・上海に駐在員事務所開設
平成16年 (2004年)	超精密平面研削盤 UPGシリーズ発売開始
平成24年 (2012年)	本社を群馬県安中市(安中工場)に移転
平成28年 (2016年)	Si貫通電極ウェーハ全自動化薄化装置 JST課題採択



創業者 岡本覚三郎



# 国内拠点、海外拠点



Okamoto Machine Tool Europe GmbH



Okamoto Machinery (Changzhou) Co., Ltd.



Okamoto Corporation

Birmingham Sales Office

Herford Sales Office (D)

Shenzhen Sales Office

Dalian Sales Office

Shanghai Sales Office

Louisville, KY Sales Office

Windsor, CT Sales Office

Silicon Valley(S.E.D) Sales Office

Santa Fe Spring, CA Sales Office



Okamoto (Thai) Company Ltd.



Okamoto (Singapore) Pte, Ltd.



本社/安中工場



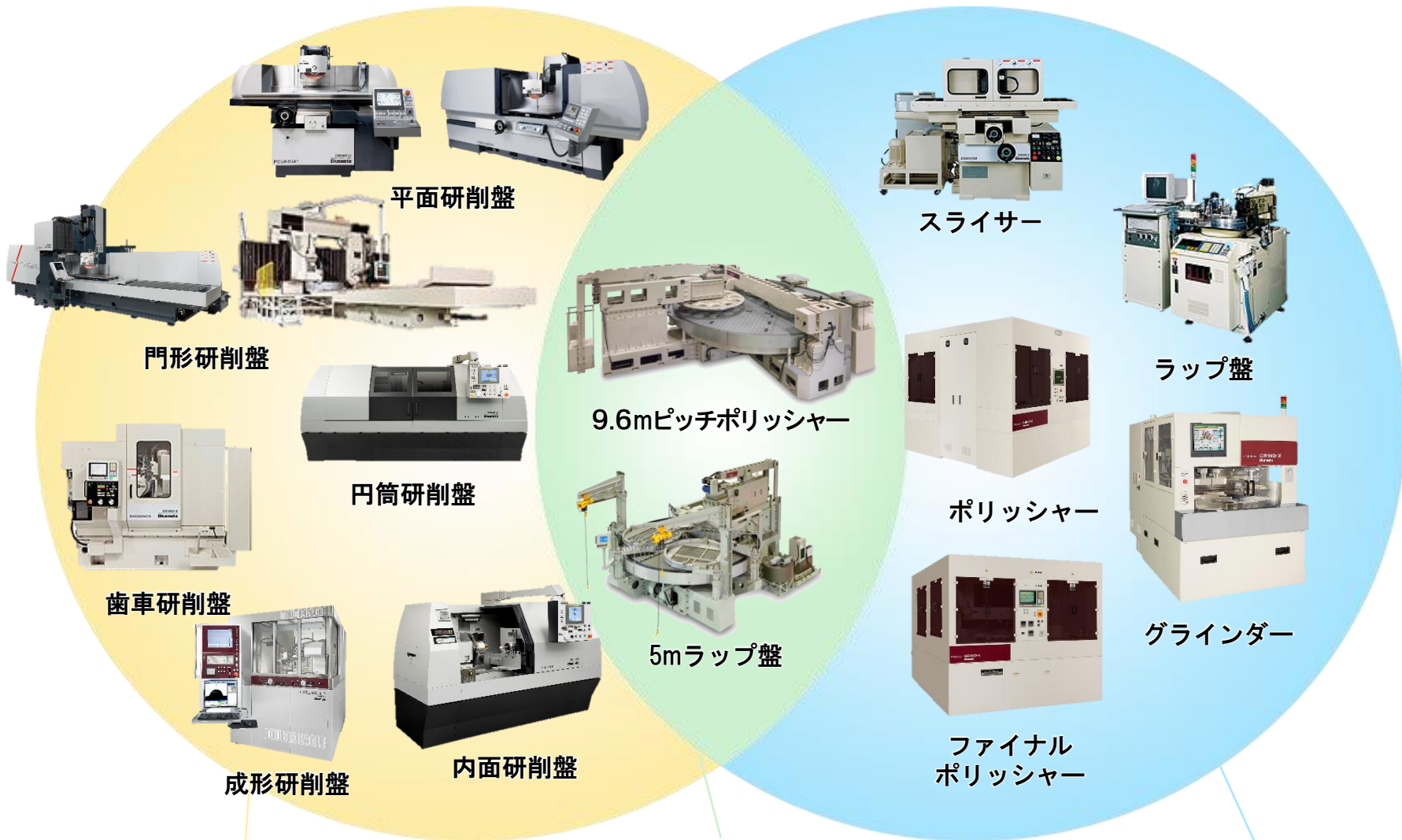
● ... 生産拠点

● ... 販売拠点

富山営業所  
 名古屋営業所  
 仙台営業所  
 広島営業所  
 北関東営業所  
 首都圏営業所  
 大阪営業所  
 岡本工機(株)  
 福岡営業所  
 技研(株)  
 静岡営業所

生産・販売拠点

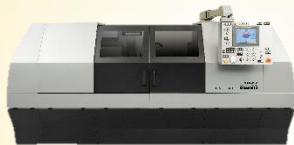
国内	9拠点
北米	5拠点
欧州	3拠点
中国	4拠点
アジア	2拠点



平面研削盤



門形研削盤



円筒研削盤



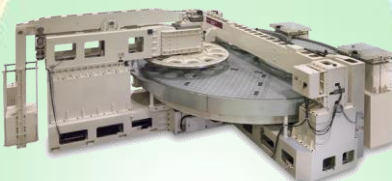
歯車研削盤



成形研削盤



内面研削盤



9.6mピッチポリッシャー



5mラップ盤



スライサー



ラップ盤



ポリッシャー



グラインダー



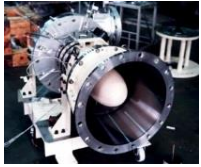
ファイナル  
ポリッシャー

金属加工機 = 工作機械

ピッチポリッシャー  
超大型ラップ盤

脆性材加工機 = 半導体製造装置

# ○ あらゆるニーズへの対応～ 豊富な機種構成



pm 1/100000000mm

## 次世代製造装置

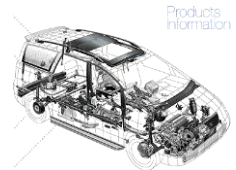
- 大口径Siウェハプロセス
- 検査用光学機器
- 衛星機器用部品
- 次世代デバイス開発プロセス



nm  
1/1000000mm

## 半導体/電子部品

- セラミックス・脆性材料の超平坦化
- 液晶関連デバイス平坦化
- Siウェハ、デバイスウェハ平坦化
- オプトデバイス



um  
1/1000mm

## 特殊市場用装置

- 航空機用部品
- 電子機器部品
- 機械構造用部品



mm

## 汎用的工作機械

- 各種治具取付具用部品
- 金型用部品
- 自動車部品
- 電気装置用部品

## 一般市場

- 家庭用包丁研ぎ
- 線路繋ぎ部分円滑化





# ○ 研削盤のシェア ～ 幅広い顧客の広がり



**1953年生産開始以来65年**

- 出荷台数 : **総計80,000台以上**
- 出荷国数 : **世界約80カ国**
- ユーザー数 : **世界20,000社以上**
- 国内推計シェア : **40%**

※半導体製造装置は除く

# 研削盤の機種別分類

700万円

2000万円

5000万円



PSG-CA1 シリーズ  
(高能率研削仕様)



スマートフォン  
時計・カメラ  
ロボット  
自動車  
他



UPZ-Li シリーズ  
(リニアモータ駆動)



液晶テレビ  
コンピュータ  
時計・カメラ  
自動車  
他



UGM360NC  
複合加工機



自動車  
船舶  
精密スピンドル  
工作機械  
他



UPG-NCシリーズ  
超精密大型研削盤



航空機  
液晶テレビ  
測定器  
工作機械  
他

# ○ 半導体製造装置の機種別分類：主力製品

6000万円



GNX200B  
SiCウェーハ用グラインダー



次世代パワー半導体SiC  
電気自動車、電車、PC  
他

15000万円



GDM300  
ウェーハ薄化用  
インライングラインダー



スマートフォン  
PC  
他



PNX332B  
ファイナルポリッシャー



8"、12"Si 材料ウェーハ

23000万円



SPP800ATB  
バッチ式ウェーハポリッシャー



スマートフォン  
SAWフィルター

# ○ 半導体製造装置の機種別分類：関連製品

7000万円



SiSG156HT  
太陽電池インゴット複合研削盤



太陽電池・ソーラーパネル

20000万円



PSG-CHシリーズ  
門形平面研削盤



SPP3800  
ピッチポリッシャー



液晶(LCD)テレビ・ディスプレイ

# ○ 当社の5つの特徴

- 1 **グローバルな販売網**
- 2 **タイ・シンガポール・アジアでの生産拠点の充実**
- 3 **一貫生産体制**
- 4 **伝統に裏打ちされた高い技術力**
- 5 **豊富な機種構成、幅広い客層、高い顧客対応力**

# 1 グローバルな販売網

Okamoto Machine Tool  
Europe GmbH



Okamoto Machinery  
(Changzhou) Co., Ltd.



Okamoto (Thai) Company Ltd.

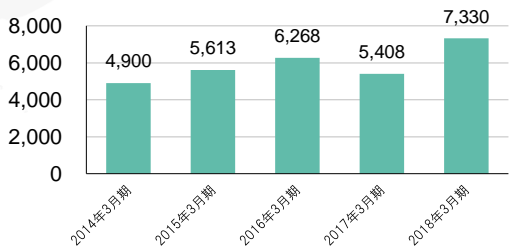
Okamoto (Singapore) Pte, Ltd.

Okamoto Corporation



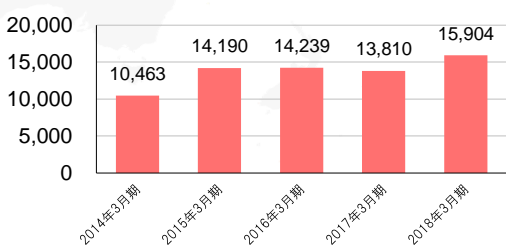
(単位:百万円)

アジア



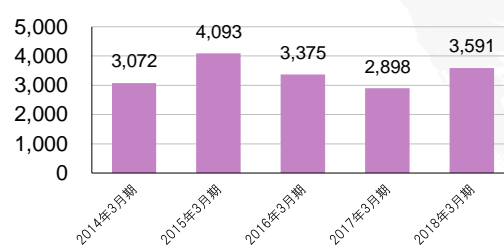
(単位:百万円)

日本



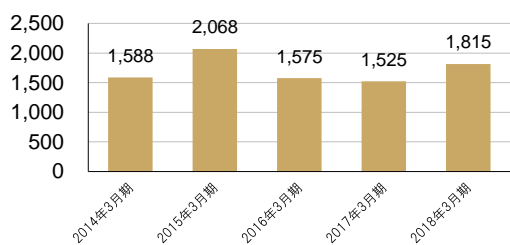
(単位:百万円)

北米



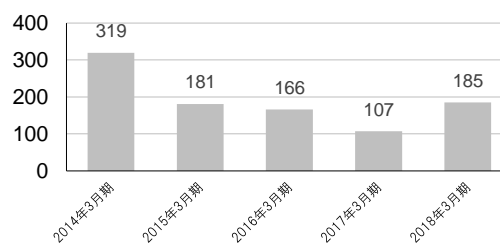
(単位:百万円)

欧州



(単位:百万円)

その他



## 2 タイ・シンガポール・アジアでの生産拠点



### OKAMOTO(SINGAPORE) PTE, LTD

10 Riverside Road, Singapore 739082, Republic of Singapore

TEL : 65-62696426

FAX : 65-62690832

<http://www.okamoto.com.sg/>



### OKAMOTO (THAI) COMPANY LTD.

174 Mu 2, Tambol Chamaeb, Amphur Wangnoi, Ayudthaya 13170, Thailand

TEL : 66-35-271187 ~ 90 FAX : 66-35-271191

<http://www.okamotothai.com/>



# 3 一貫生産体制



## 安中工場



**基幹工場**  
(徹底した温度管理、クリーンルーム)

## シンガポール

精密加工機の設計・生産



## タイ

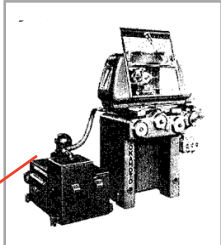
鑄物の生産、一般機の量産



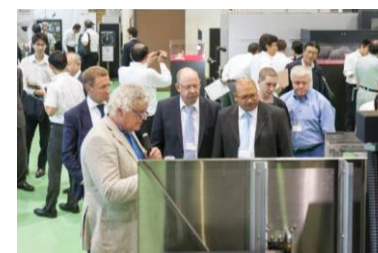
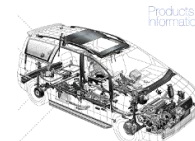
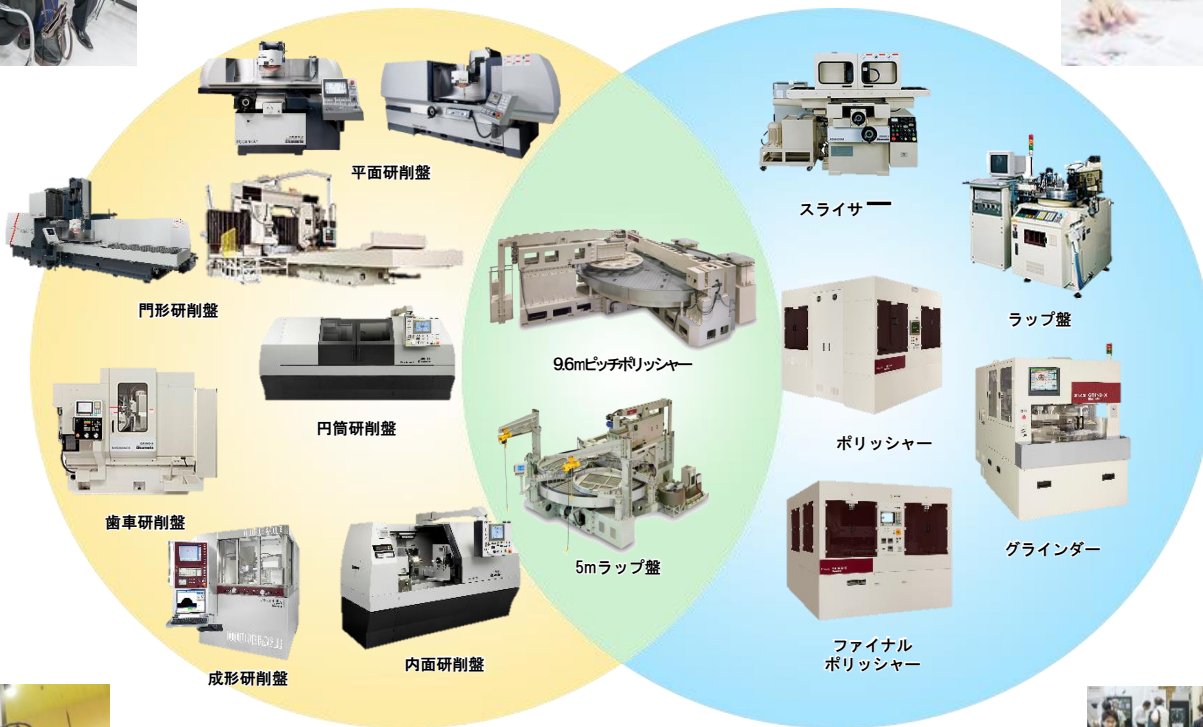


# 4 伝統に裏打ちされた高い技術力

大正15年 (1926年)	岡本覚三郎が岡本専用工作機械製作所を創業
昭和5年 (1930年)	国産初の歯車研削盤 ASG-2型を完成
昭和10年 (1935年)	(株) 岡本工作機械製作所創立
昭和28年 (1953年)	国産初の平面研削盤PSG-6型完成
昭和30年 (1955年)	国産初の外周刃スライディングマシン PSG-3GE型を完成
昭和38年 (1963年)	東京証券取引所市場第二部上場
昭和43年 (1968年)	世界初のCNC成形研削盤 NFG-5型を完成
昭和47年 (1972年)	米国に、オカモト・コーポレーション設立
昭和48年 (1973年)	シンガポール工場完成
昭和57年 (1982年)	群馬県安中市に安中工場完成
昭和61年 (1986年)	タイ工場完成
平成4年 (1992年)	ドイツに、オカモト・ヨーロッパ設立
平成8年 (1996年)	半導体事業本部を設立
平成9年 (1997年)	全自動立型高精度平面研削盤の開発で日本機械学会 技術賞受賞 全自動高精度高能率CMP装置の開発で砥粒加工学会 技術賞受賞
平成12年 (2000年)	高精度成形研削盤 UPZシリーズを完成
平成13年 (2001年)	スキヤニングポリシャーGNX300Pを完成
平成14年 (2002年)	中国・上海に駐在員事務所開設
平成16年 (2004年)	超精密平面研削盤 UPGシリーズ発売開始
平成24年 (2012年)	本社を群馬県安中市(安中工場)に移転
平成28年 (2016年)	Si貫通電極ウェーハ全自動化薄化装置 JST課題採択



# 5 豊富な機種構成、幅広い顧客、高い顧客対応力



# II

## 2018年3月期 決算概況

## 半導体関連と国内市場が好調

### 【国内市場】

- 工作機械業界や半導体関連装置業界向けに**大型研削盤や高精度タイプの研削盤、ロータリー研削盤**などの需要が高まり、売上は前年度を上回り、受注も好調に推移
- 特に半導体関連装置はウェーハメーカーの増産対応などの設備投資を中心に好調を継続。
- 歯車、鋳物も前年度を上回る

### 【海外市場】

- 北米は航空機、自動車部品などの業種を中心に堅調
- 欧州は需要は安定。フランスやイタリアで汎用タイプの研削盤の受注が増加。半導体関連装置の貢献もあり売上も前年度を上回る
- 中国では、自動化設備やNEV関連投資が旺盛、工作機械は売上、受注とも好調に推移。半導体関連装置も中国及び東アジアで販売が高水準に推移

# 業績ハイライト

(単位:百万円、%)

	2017年3月	2018年3月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	23,749	28,827	+21.4%
売上総利益	7,085	8,872	+25.2%
販売費及び一般管理費	5,945	6,854	+15.3%
営業利益	1,139	2,017	+77.0%
経常利益	768	1,707	+122.2%
当期純利益	577	1,983	+243.5%

※小数点第2位を四捨五入

(単位:百万円)

	2017年3月	2018年3月
	金額	金額
設備投資額	960	1,274
減価償却費	1,158	1,181
研究開発費	106	95
<b>為替レート</b>	<b>2017年3月</b>	<b>2018年3月</b>
米ドル	108.72	110.70
シンガポールドル	78.39	81.89
ユーロ	118.68	130.25
タイバーツ	3.10	3.36
人民元	16.10	16.78

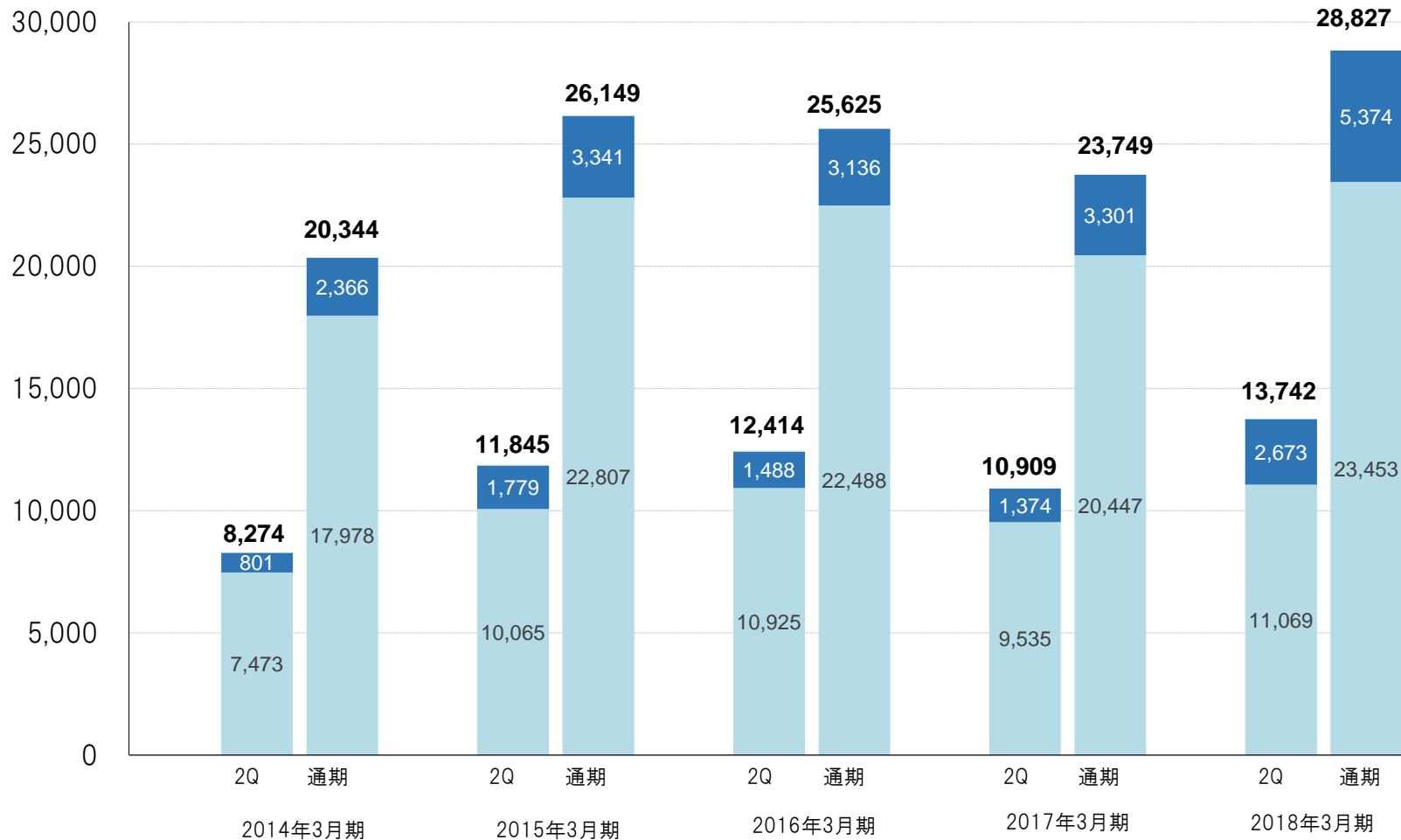
※期中の平均レートで記載しております。

- ▶ 前期比で売上高は50億78百万円、21.4%増加。営業利益は8億78百万円、77.0%増加
- ▶ 投資意欲が旺盛な中国及び東アジアで半導体関連装置の販売、受注が好調
- ▶ 国内も工作機械業界向けに大型研削盤、半導体関連業界向けにロータリー研削盤などが好調に推移

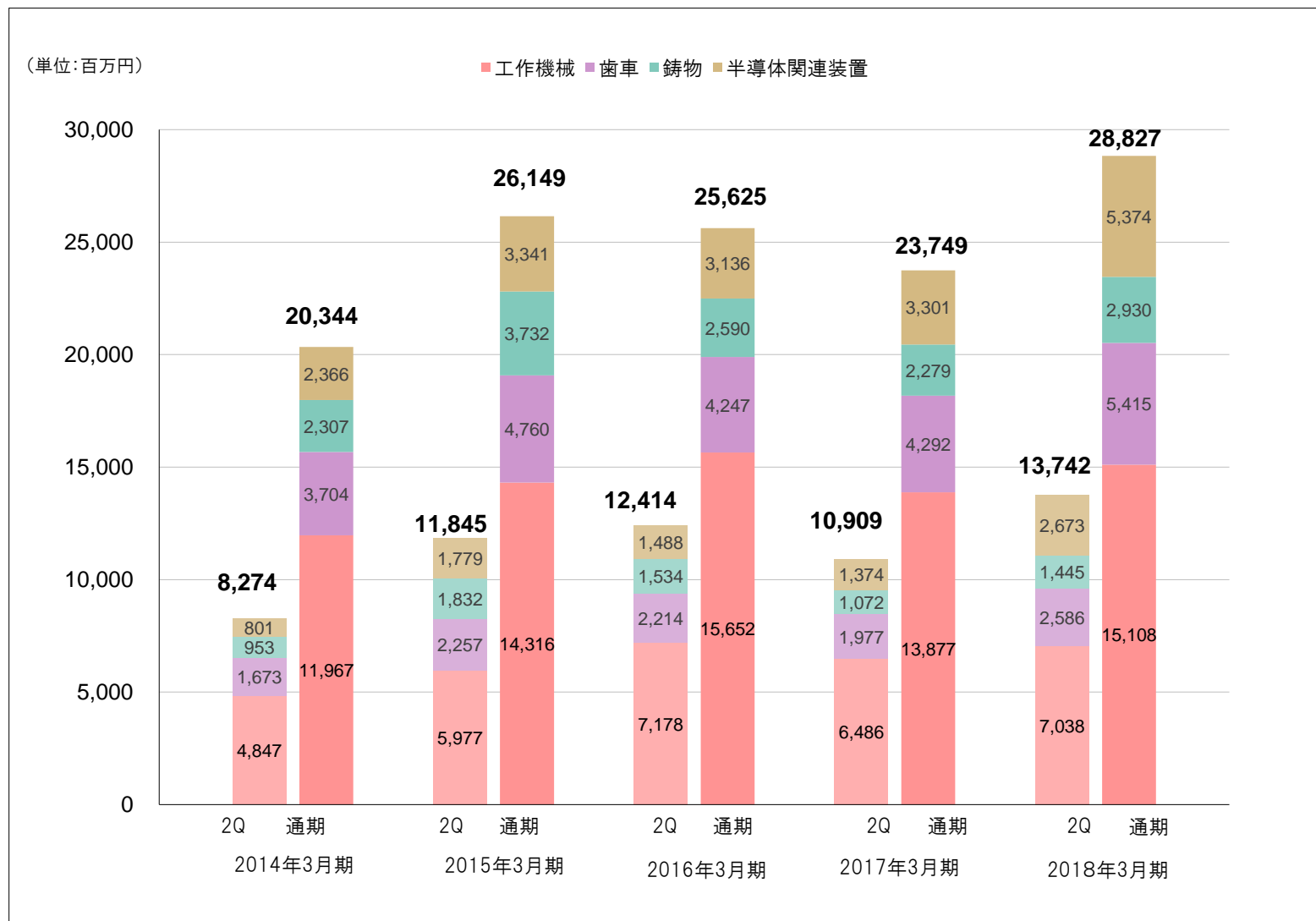
# セグメント別売上高推移

(単位:百万円)

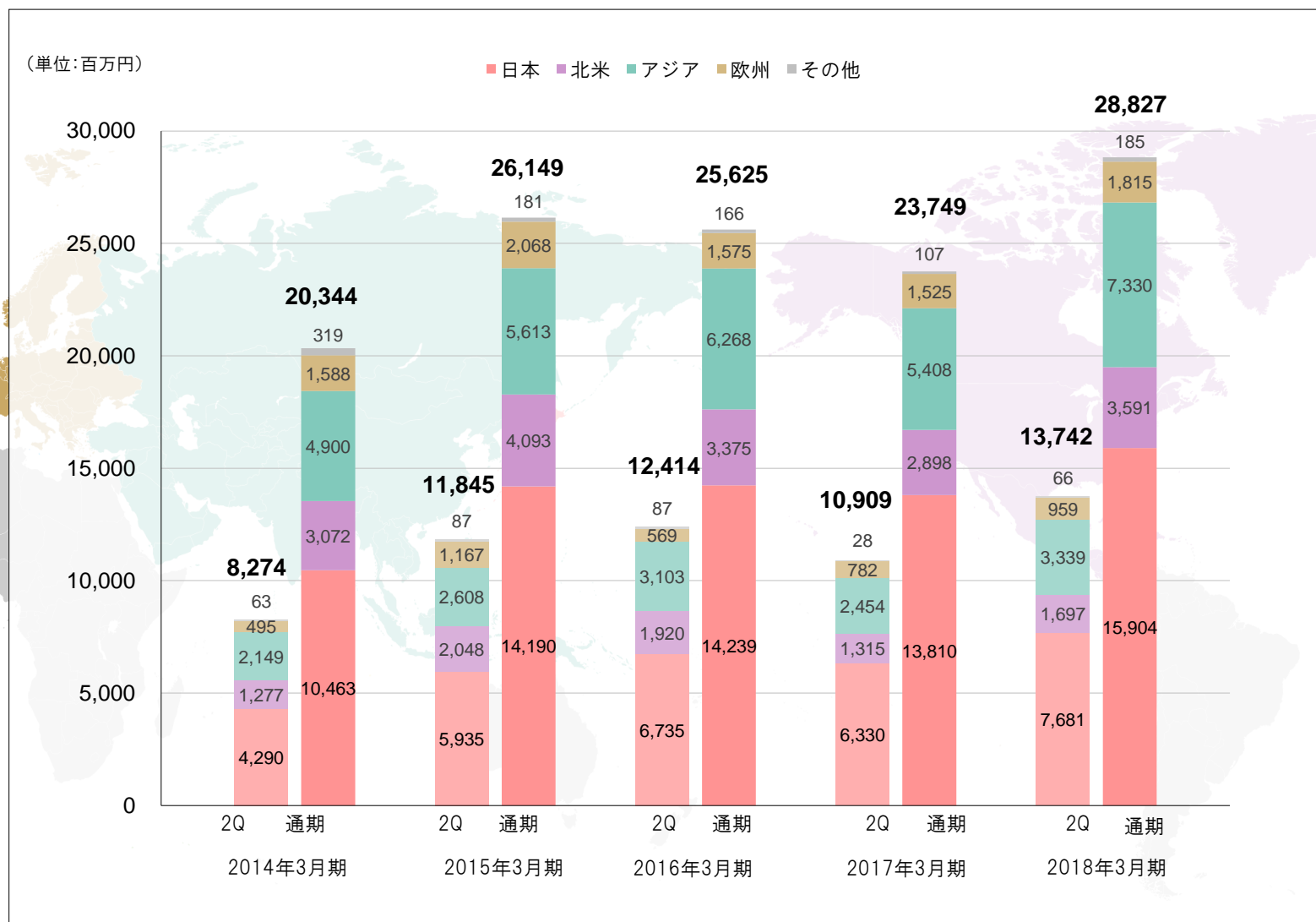
■ 工作機械 ■ 半導体関連装置



# ○ セグメント別売上高推移②



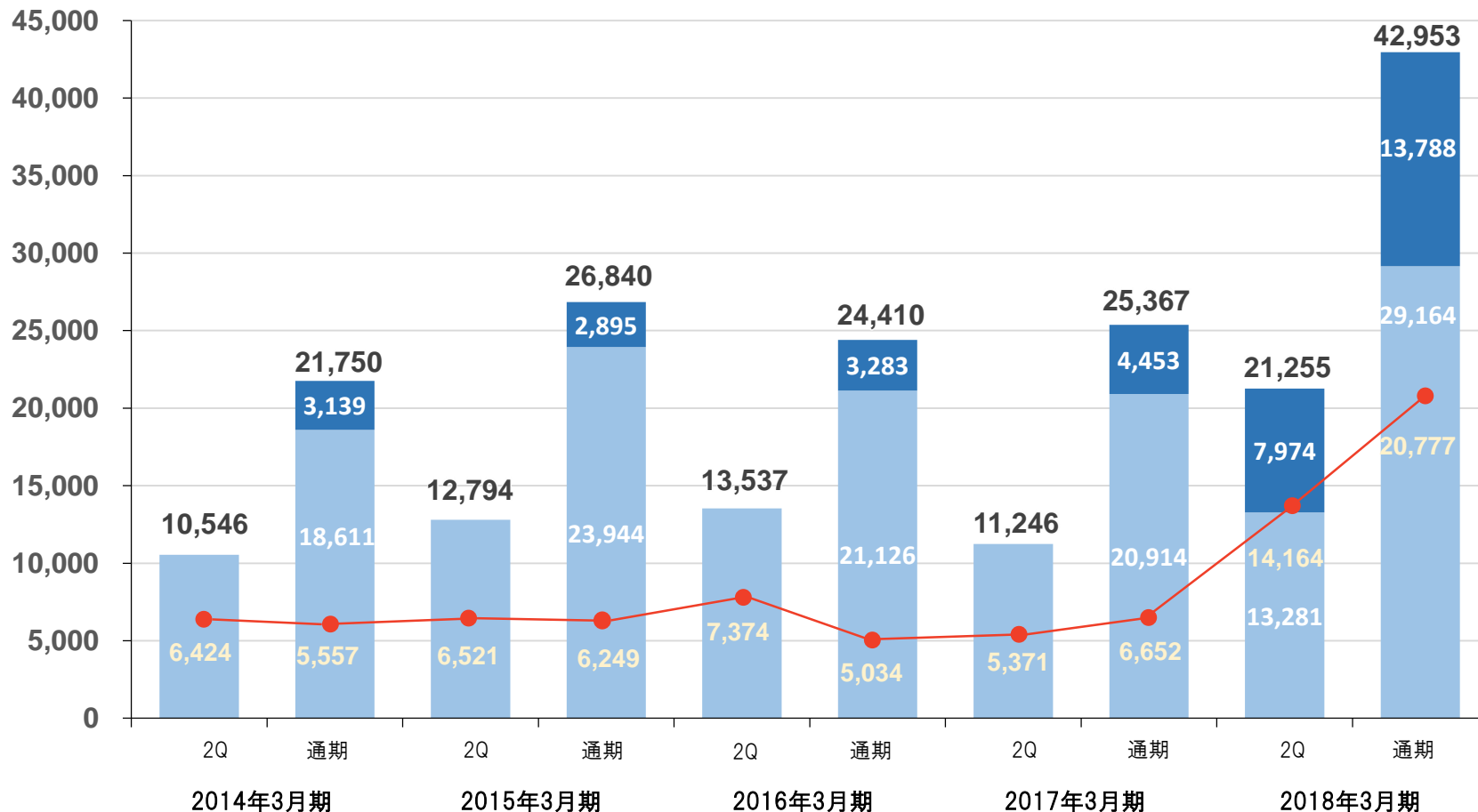
# ○ エリア別売上高推移





# ○ 受注・受注残高推移

(単位:百万円)



※2Qについては2018年3月期よりセグメント別に表示しております。

# ○ 比較貸借対照表

(単位:百万円)

	2017年3月	2018年3月	
	金額	金額	対前期末比
流動資産	18,233	20,785	+2,552
現金及び預金	3,699	3,512	▲187
受取手形及び売掛金	7,661	8,291	+630
棚卸資産	6,472	7,982	+1,510
有形・無形固定資産	9,630	9,792	+162
投資等	409	795	+386
資産合計	28,273	31,374	+3,101

(単位:百万円)

	2017年3月	2018年3月	
	金額	金額	対前期末比
負債合計	18,803	20,048	+1,245
流動負債	13,793	16,236	+2,443
固定負債	5,009	3,811	▲1,198
純資産合計	9,470	11,326	+1,856
負債資本合計	28,273	31,374	+3,101

## <総資産(前期末比+3,101m)>

- 流動資産の増加 2,552m
- ・受取手形・売掛金の増加 630m
- ・現預金の減少 ▲187m
- ・棚卸資産の増加 1,510m
- 投資等の増加 386m ……退職給付に係る資産 375m

## <負債(前期末比+1,245m)>

- 支払手形・買掛金の増加 1,656m ……仕入の増加
- 流動負債その他 1,285m ……前受金 816m、賞与引当金 116m
- 借入金減少 ▲1,926m ……(連結)調達/520m⇔返済/▲2,511m

## <純資産(前期末比+1,856m)>

- 当期純利益 +1,983m、為替換算調整勘定 +110m
- 配当金の支払い ▲265m

# ○ 比較キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

	2017年3月		2018年3月	
	金額		金額	対前期末増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,181		3,201	+2,020
税引前当期純利益	850		1,702	+852
減価償却費	1,158		1,181	+23
売上債権の増減 (▲は増加)	▲444		▲600	▲156
棚卸資産の増減 (▲は増加)	▲183		▲1,484	▲1,301
仕入債務の増減 (▲は減少)	61		1,571	+1,510
その他	▲261		831	+1,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲772		▲664	+108
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲631		▲2,403	▲1,772
換算差額	16		15	▲1
現金・同等物残高	3,305		3,455	+150

- 現金・同等物は、前期末比150m増加の3,455m
  - 営業CF 3,201m
    - ・税引前当期純利益 1,702m、減価償却費 1,181m、売上債権の増加 ▲600m
  - 投資CF ▲664m
    - ・設備投資 ▲1,001m
  - 財務CF ▲2,403m
    - ・借入金の減少 ▲1,991m

# III

## 2019年3月期 業績予想

## 中期経営計画 2019年3月期売上320億円

(単位:百万円、%)

	2018年3月	2019年3月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	28,827	32,000	+11.0%
売上総利益	8,872	10,100	+13.8%
販売費及び一般管理費	6,854	7,500	+9.4%
営業利益	2,017	2,600	+28.9%
経常利益	1,707	2,350	+37.7%
当期純利益	1,983	1,650	▲16.8%

※小数点第2位を四捨五入

(単位:百万円)

	2018年3月	2019年3月 (予想)
	金額	金額
設備投資額	1,274	1,728
減価償却費	1,181	1,129
研究開発費	95	115

為替レート	2018年3月	2019年3月 (予想)
米ドル	110.70	110.00
シンガポールドル	81.89	81.02
ユーロ	130.25	130.00
タイバーツ	3.36	3.30
人民元	16.78	16.70

※期中の平均レートで記載しております。

# ○ 2019年3月期の工作機械関連の市場環境見通し

## 【国内市場】

- 設備投資は、緩和的な金融環境のもとで、能力増強投資や、人手不足に対応した省力化投資を中心に、増加を続けると予想
- 歯車はロボット関連での受注増加を見込む
- 鋳物の生産については、現状レベルでの推移を予想

## 【海外市場】

- 北米は引き続き自動車、航空機、医療、半導体関連を中心に底堅い動き。更に法人税減税策により、年末に向け設備投資が増加する予想
- 欧州はドイツ、フランス、イタリア、ポルトガルなどで自動車、プラスチック金型、機械部品関連で堅調な動き
- アジアは特に中国でEV自動車関連の電池関連、減速機、ロボット関係部品、工作機械部品関連が引合い活発で堅調な動き

# ○ 2019年3月期の半導体関連装置の市場環境見通し

## 【国内市場】

- 自動車のAI化やIoTに求められる半導体の多様化等の要因により、依然として半導体の製造が活況。

300mmウェーハ需給逼迫の影響を受け、大手国内メーカーにあっても、生産能力を補強する為の設備投資を継続中。

弊社製品においては、ファイナルポリッシャーを中心とした高額装置の受注が好調。

## 【海外市場】

- “半導体大国”を目指す中国においては、続々と半導体工場の新設計画が進行中。同工場にて必要となる半導体製造装置についても、当面の間は設備投資の拡大が見込まれる。



PNX332B



GNX300B

# IV

## 中期経営計画と進捗状況

Mission GX2019



# ○ 中期経営計画施策 営業

セグメント	施策
工作機械	①海外販売の強化(北米、中国を戦略拠点に) ②新規開発機種重点販売 ③国内外の販売シェアの拡大
半導体関連装置	①ポリッシュ装置重点販売 ②次世代パワー半導体用SiC、GaN サファイア等の脆性材加工装置の拡販
工作機械(歯車)	①拡大するロボット、自動車市場への拡販 ⇒ 岡本工機 新工場立ち上げ
工作機械(鋳物)	①新規顧客の開拓

# ○ 具体的施策 海外販売の強化 今期進捗状況

## 米国・中国で販売順調に推移

### 米国

- ◆ 4拠点でのショールーム活用で、来客数も増加し販売に貢献
- ◆ 汎用機の特販・大型機の更新需要もあり、販売台数の増加
- ◆ 半導体装置関連用セラミック関連用向け部品加工需要増加
- ◆ 自動化対応専任者を採用し、自動化の提案を拡大中
- ◆ 大型金型向け設備投資が活発化し、大型機の需要増加

### 中国

- ◆ 中国内生産を開始、見える化により認知度及び顧客の安心感が高まり販売も順調に推移
- ◆ 自動化需要であるロボット部品の特殊部品加工で認知度が上がり、販売拡大
- ◆ 工作機械関連部品需要増加し、販売も堅調に推移
- ◆ 営業部員を増員して販売力を強化

# ○ 具体的施策 戦略機種への投入

## 複合研削盤、サドル型、コラム型新シリーズの投入

### ≫ 複合研削盤(円筒研削盤ベース)

- ・国内外からの引き合い多数
- ・ポリゴン研削等の特殊加工用のアプリケーションも開発中



### ≫ サドル/コラム型平面研削盤の新シリーズ

- ・次期主力機種となる PSG-SA1/CA1シリーズの販売を開始し、受注の滑り出し好調



### ≫ 大型平面研削盤のコストダウン機

- ・静圧スライド高精度機の受注が依然増加中
- ・各種テーブルサイズのシリーズ化にも対応
- ・コストダウン効果による利益率の拡大に期待
- ・大型機の海外需要増加



# ○ 中期経営計画施策 技術・生産

## 施策

1. 品質向上
2. 平準化
3. サービス体制の強化
4. コストダウン
5. 効率化

## 具体的施策

- ◆ QCD改善活動を通じ変動費を削減する
- ◆ 規格・モジュール化推進による品質の向上とコストダウン
- ◆ 3D CAD化推進による設計効率化と品質の向上
- ◆ 集中サービスセンターによるパーツ即納体制を確立
- ◆ 歯車生産のライン化、自動化による、品質安定、効率化
- ◆ 管理系システム再構築による効率化、品質向上

## QCD改善活動によるコスト削減に注力

### 1. QCD改善活動を通じた変動費の削減

Q(品質)、C(コスト)、D(納期)

- ・ 初期クレームの削減  
119期は前期と同一水準
- ・ 資材調達機能強化（グローバル調達含む）  
119期目標を上回り達成済
- ・ 生産性向上による内製化の推進  
119期目標を上回り達成、半導体部品加工内製も目標を上回る  
QCD改善活動全施策による変動費削減実績は、目標を上回り達成

# ○ 中期事業計画の骨子 ～ 技術・生産 進捗状況②

## モジュール化、3D CAD化などの推進も順調に進捗

### 2. 規格・モジュール化推進による品質の向上とコストダウン

- ・引き続き、社内標準規格の充実化を推進中
- ・主要平面研削盤シリーズであるCA及びCHシリーズにおいて、ユニットモジュールを使用することにより構造の選択を容易にし、後工程を簡素化できる設計スタイルを構築
- ・順次、各種テーブルサイズのシリーズ化を実現

### 3. 3D CAD化推進による設計効率と品質の向上

- ・社内/外注加工における3Dデータの活用率向上により、短納期化とコストダウンに寄与
- ・新機種開発時の機械剛性確認における3D解析ソフトの使用が定着
- ・3Dモデリング未対応の機種についても、順次、同データを作成・構築中

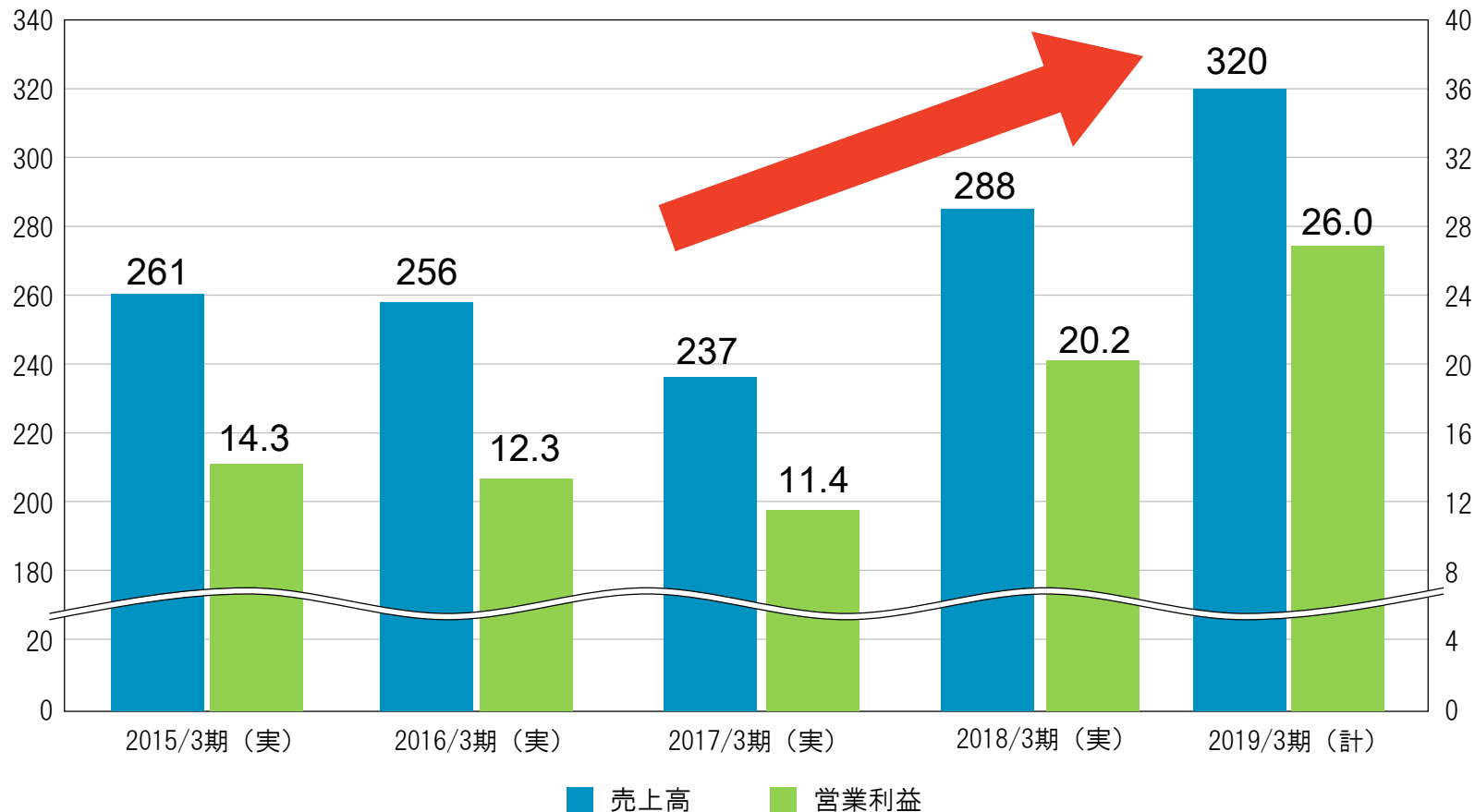
### 4. 集中サービスセンターによるパーツ即納体制を確立

- ・インフラ整備と、半導体サービス増員による強化実行中

# ○ 中期目標

売上高 億円


営業利益 億円



営業利益率目標 8%

海外売上高比率 60%

究極の  
平面創成



**Okamoto**



**本資料に関するお問い合わせ先**

**株式会社 岡本工作機械製作所**  
**総務部**  
**TEL 027(385)5800**

**【本資料お取り扱い上のご注意】**

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所(以下、当社)をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。